证券代码：688361　　证券简称：中科飞测　　公告编号：2026-041

深圳中科飞测科技股份有限公司
关于第 2,000 台集成电路质量控制设备出机的自愿性披露公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 近日，深圳中科飞测科技股份有限公司（以下简称“公司”）第2,000台集成电路质量控制设备正式出机并发往国内某知名集成电路制造商，充分彰显公司的产品、服务以及技术实力获得市场高度认可，进一步巩固了公司在核心技术、客户资源、产品覆盖深度和广度等方面竞争优势，体现国产高端半导体质量控制设备自主可控能力稳步提升。
- 本次设备出机是按照已签署订单交付设备，已对价格等内容做出了明确约定，签署双方也均有履约能力，但在订单履行的过程中如果遇到市场、政策等不可预计或不可抗力等因素的影响，有可能存在无法履行的风险，公司将积极做好相关应对措施，全力保障订单的正常履行。

一、本次设备出机情况及对公司影响

近日，公司第 2,000 台集成电路质量控制设备正式出机并发往国内某知名集成电路制造商，充分彰显公司的产品、服务以及技术实力获得市场高度认可，进一步巩固了公司在核心技术、客户资源、产品覆盖深度和广度等方面竞争优势，体现国产高端半导体质量控制设备自主可控能力稳步提升。目前，公司十三大系列集成电路量检测设备涵盖光学、电子束以及 X 光三大核心技术，覆盖逻辑、存储、特色工艺、先进封装、硅片与制程设备等不同类型半导体行业客户，已批

量进入国内先进制程大产线，多项核心技术指标达到国际领先水平。凭借持续的技术创新能力、稳定的产品品质及完善的售后服务，公司积累了优质客户资源和良好品牌知名度，并与客户建立了长期合作关系，从而保证公司订单和市场份额随着客户的发展而持续、稳定地增长。

同时，随着公司设备出货量提升，“设备+软件+服务”全流程良率管理解决方案的协同效应逐步释放，有望带动软件、关键耗材与维保服务业务量持续提升，为公司贡献持续稳定的利润增长点。

未来，公司将继续坚持核心技术的自主创新，紧跟先进制程、HBM、2.5D/3D封装等行业发展前沿趋势及客户需求，持续推进新产品以及现有产品向更前沿工艺的研发和产业化，不断优化运营管理及客户服务保障体系，为客户提供更高效、更全面覆盖的良率管理解决方案，进一步提高产品市场表现及核心竞争力。

二、相关风险提示

本次设备出机是按照已签署订单交付设备，已对价格等内容做出了明确约定，签署双方也均有履约能力，但在订单履行的过程中如果遇到市场、政策等不可预计或不可抗力等因素的影响，有可能存在无法履行的风险，公司将积极做好相关应对措施，全力保障订单的正常履行。

敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳中科飞测科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 31 日